

# 연수 제안서

|  |  |
|--|--|
| 연구 분야  | 고분자합성 및 물성                             |
| 연구 과제명   | 자연모사 기반 20W/mK급 경량 고방열 회로기판<br>제조기술 개발 |
| 연수 제안 업무   | 열경화성 고분자합성 및 물성                        |
| <p><b>열경화성 고분자기반 복합소재의 고기능화</b></p> <p><b>1. 열경화성 고분자의 합성</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 에폭시 기반 고분자의 분자구조 설계 및 합성</li><li>- 새로운 열경화성 수지의 설계 및 합성</li><li>- 경화제, 경화촉진제, 잠재성 경화제의 설계 및 합성</li><li>- 재활용 가능한 신규 열경화성 고분자의 합성 및 메카니즘 규명</li></ul> <p><b>2. 열경화성 고분자 기반 복합소재 제조</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 신규 열경화성 고분자의 경화조건 탐색</li><li>- 필러/고분자 복합소재 제조 기술</li><li>- 열경화성 수지의 포콜레이션 기술</li></ul> <p><b>3. 고분자 및 복합소재의 성능 평가</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 강도, 인성, 내열성, 유리전이 온도, 열전도도등 평가</li></ul> |  |
| <p>소속 부 서 : 탄소융합소재연구센터</p> <p>연수 책임자 : 고 문 주</p>   |  |